

2024 年 1 月吉日

## 第 38 回ネプコンジャパン出展のご案内

2024 年 1 月 24 日より開催されます、第 38 回ネプコン ジャパン-エレクトロニクス開発・実装展『第 1 回パワーデバイス&モジュール EXPO』に出展いたします。

省エネルギー、低炭素化社会の要求において、低消費電力、高効率電力変換に重要なパワーデバイスの測定や環境試験（高温・低温）など半導体製品の品質・高性能を担保するための検査装置をご提案致します。

今回は個別半導体を中心とした素子の静特性を測定するテストシステム 431-TT や、QFN、BGA、WLCSP などのリードレスデバイスをそのままウェハリング上でテストするハンドラ 5170-IH の実機展示を致します。

ぜひとも弊社ブースにご光臨賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

### 【開催概要】

開催展名：第 38 回 ネプコン ジャパン -エレクトロニクス 開発・実装展

構成展：第 1 回パワーデバイス&モジュール EXPO

会 期： 2024 年 1 月 24 日(水)～1 月 26 日(金)

会 場： 東京ビッグサイト

場 所： 東展示棟 東 4 ホール 小間位置【E35-34】

公式 HP：[www.tesec.co.jp](http://www.tesec.co.jp)

### 【出展製品】

ディスクリットデバイス テストシステム 431-TT

フィルムフレームテストハンドラ（MAP ハンドラ） 5170-IH

[→詳細はこちら](#)

